

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: TSSOP16およびSOIC16 ; フリースケール天津組立工場の拡張

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2011年12月20日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

Japan Regional Marketing

該当GPCN番号:

14968

変更内容:

フリースケールセミコンダクタは、TSSOP16とSOIC16のパッケージで、この通知に記載された製品の柔軟な生産供給に対応するため組立工場を追加します。これらは、現在、南通富士通マニュファクチャリングエンタープライズ (NFME)、アドバンストセミコンダクタエンジニアリングチョンリー (ASECL) またはアムコアテクノロジー (ATP1) で組み立てられています。フリースケールセミコンダクタ天津 (FSL TJN FM) を、これらのパッケージの追加の組立サイトとして認定しました。

変更理由:

NFME/ASECL/ATP1とFSL- TJN - FMとでのアセンブリサイトによる柔軟な生産容量の向上は、顧客の需要に対応するため。

対象製品:

MC908KX2CDWE
MC908KX2CDWER
MC908KX2MDWE
MC908KX2MDWER
MC908KX2VDWE
MC908KX8CDWE
MC908KX8CDWER2
MC908KX8MDWE
MC908KX8VDWE
MC9RS08KA4CTG
MC9RS08KA4CTGR
MC9RS08KA4CWG
MC9RS08KA4CWGR
MC9RS08KA8CTG
MC9RS08KA8CWG
MC9RS08KA8CWGR
MC9RS08KB12CTG
MC9RS08KB4CTG
MC9RS08KB8CTG
MC9S08QG4CDTE
MC9S08QG4CDTER
MC9S08QG4MDTE
MC9S08QG8CDTE
MC9S08QG8CDTER

変更（変更品出荷）時期：

変更開始日： 16-Mar-2012

--

変更品の見分け方：

デバイスの形状、FIT値、機能の信頼性に影響はありません。

--

その他：

--